スパッタリング法による ITO 薄膜の熱処理効果

Thermal treatment effect of ITO thin film using sputtering method

一戸 善弘

Yoshihiro ICHINOHE*

Abstract

This paper examines thermal treatment effect of ITO(In2O3:Sn) that using as transparent electrode in a solar cell. This ITO was prepared by a sputtering method and subjected to heat treatment at 300 - 500 °C. A peak of ITO(222) and (400) was observed from the result of X-ray diffraction of all samples. In a sample having a heat treatment temperature at 400 °C shown the largest ITO(400) peak value. Also, it was confirmed with the naked eye that Sn was precipitated in a sample having a heat treatment temperature at 500 °C. This result is thought to be due to heat treatment under ultrahigh vacuum. The size of the crystal grain was also evaluated. As a result of the evaluation, the crystal grain size became the smallest at 400 °C, but the reason for this is unknown now.

1. はじめに

近年、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導 入が進められている。しかし、太陽光発電は他のエ ネルギーによる発電に比べると単位面積当たりの コストが高い。また現在のところ、太陽電池の光エ ネルギーを電気エネルギーに変換する効率は、汎用 品の太陽電池で 20%ほどであり、これを理論的な 最大限である 27%に上げることができれば、現在 利用している面積よりも小さい面積で同じ発電量 を期待することができる。そこで、本研究室では Si(シリコン)よりも光の吸収係数が大きい CIS (CuInSe₂:銅インジウムセレン) に着目し、高効率 な薄膜太陽電池としての検討を行っている。 実際に デバイスとして太陽電池を作製するためには透明 電極が欠かすことができない。近年、一般的に透明 電極として用いられる材料としては ITO(In₂O₃:Sn:酸化インジウム錫)と ZnO(酸化亜 鉛)が知られており、ITO は In₂O₃ (酸化インジウ ム)に Sn(錫)をドープした材料で、すでに太陽 電池や液晶ディスプレイ、タッチパネルなどにも広 く用いられている。ITO は通常の条件下では Bixbyite (ビクスビ鉱)型 の立方晶構造型を持ち、 3.75eV のバンドギャップを持つため、可視光領域 が透明である。一方、ZnO は Wurtzite(六方ウルツ鉱)型の結晶構造を持ち、バンドギャップが 3.37eV であるため、ITO と同様に可視光領域で透明である。今回、我々は透明電極として ITO を用いるが、これは CIS が Chalcopyrite(カルコパイライト)型の立方晶構造型に属するため、ITO と共通の結晶構造を持つためである。そのため、ZnO を透明電極として用いる一般的な CIS 太陽電池において必要なバッファ層が不要になると考えられる。

本研究では、新規に導入したITOスパッタリングターゲットを用いて、CISを太陽電池デバイスとして使用するために欠かせないITO透明電極の製膜条件について、主に結晶性の観点から検討を行う。

2. 研究方法

実験手順としては、まずスパッタリング法による ITOの製膜、次に真空中で熱処理を行い、完成した 試料について X 線回折により、結晶構造などを調べ、 分光光度計で透過率の測定を行う。

2.1. スパッタリング装置による ITO 膜の作製

スパッタリング法により ITO をガラス基板に蒸着させる。スパッタリング装置にて真空にし、Ar (アルゴン) を入れて放電すると、イオン化された

Ar が原料の ITO に衝突し、原子を叩き出す。この原子がガラス基板に付着することで製膜できる。本研究では、アネルバ株式会社製スパッタリング装置「L-250S-FH」を用いて、基板としてソーダガラス基板(MATSUNAMI Micro Cover Glass 18×18 mm, Thickness No.4)へ ITO スパッタリングターゲット(高純度科学、 $\ln_2 O_3$ -Sn O_2 9:1)を真空度 6.0×10^{-1} Pa の状態で基板温度は室温(約 300K)、出力50W、60 分間堆積させた。

2.2. 高真空下での熱処理

スパッタリング法で蒸着した状態では結晶にはなっていないため、高真空下で熱処理を行うことにより結晶化させる。これにはアネルバ製MBE(Molecular Beam Epitaxy:分子線エピタキシー)装置内で、カーボンヒーターによって加熱を行う。本研究で用いる MBE 装置での熱処理条件を表 1 に示す。

表 1 熱処理条件

熱処理温度[°C]	300	400	500	
処理時間[h]	2			
背圧[Pa]	10 ⁻⁷ 台			

2.3. X 線回折装置による結晶性の測定

完成した試料について、X 線回折により評価する。 今回、我々は Rigaku Smart Lab ($CuK\alpha 1$, λ =1.540 Å)を用いて、アウトプレーン回折法にて θ =20~50deg で 2h の測定を行った。

2.4. 分光光度計で透過率の測定

試料について、分光光度計により透過率の測定を 行った。我々は島津製作所 UV-1650PC を用いて 400nm から 700nm の波長領域で測定を行った。

3. 実験結果

3.1. X 線回折の結果

図 1~3 は 300~500°C で熱処理した試料の X 線回折の結果である。全ての試料において、20°~40°に幅広い回折線のピークがある。これは基板として用いているガラスからのピークである。図 1 の熱処理温度が 300°C の試料からは 30.6°、35.0°付近に回折線のピークが確認できた。それぞれ ITO(222)、ITO(400)のピークである。熱処理温度 400°C の場合も熱処理温度 300°C と同様に ITO(222)、ITO(400)のピークが確認できた。300°C に比べ、ITO(400)のピークが大きくなり、バックグラウンドノイズが

小さく見える。熱処理温度 500°C (図 3) では、ITO(222) やITO(400)の他にITO(211)などのITOのピークや

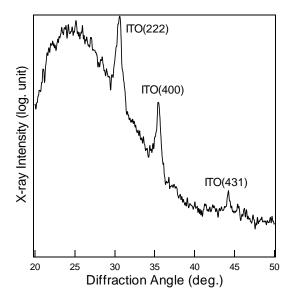


図1 X線回折の結果(熱処理温度300°C)

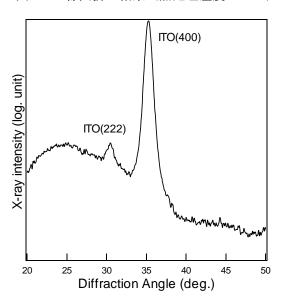


図2 X線回折の結果(熱処理温度 400°C)

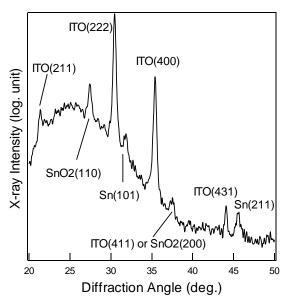


図3 X線回折の結果 (熱処理温度 500°C) $SnO_2(110)$ 、Sn(101)などと見られる回折線のピークが確認できた。これは処理温度が 500°C と比較的高温で、かつ高真空下での熱処理だったため、Snが金属として析出したためだと考えられるが(後述の図 5(c)を参照)、詳細は不明である。

3.2. 透過率測定の結果

図 4 に透過率の測定結果を示す。また、図 5(a) ~(c)に各処理温度で熱処理した試料の外観を示す。熱処理温度 300°C の試料の方が、熱処理温度 400°C よりも透過率が高かった。これは試料外観の観察結果からも矛盾はない。また、熱処理温度 400°C においては 500~650nm では透過率が低下している。この波長領域は青~緑であるから、試料の色は補色にあたる黄色に見えると考えられるが、この結果も試料外観と矛盾はない。一方、熱処理温度が 500°C の試料では黄色い斑点が出現した。これは X 線回折の結果から Sn の析出ではないかと考えられる。

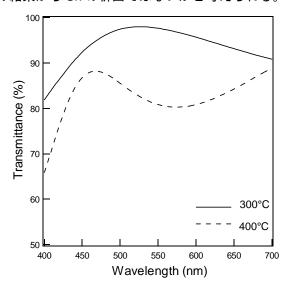


図 4 可視光領域の透過率の結果



図 5(a) 熱処理温度 300°C の試料外観



図 5(b) 熱処理温度 400°C の試料外観



図 5(c) 熱処理温度 500°C の試料外観

4. 考察

X線回折の結果から、熱処理後の結晶粒の大きさについて評価する。結晶粒の大きさは Scherrer⁽¹⁾によって式(1)で示されている。

$$D = \frac{K\lambda}{B\cos\theta} \quad \vec{x}(1)$$

ここでDは結晶粒の大きさ[Å]、Kはシェラー定数、 λ は測定 X 線の波長[\mathring{A}]、Bは回折線幅[rad]、 θ は回 折角[rad]である。なお、この式は結晶粒の大きさDが 0.1μm 程度以下のものしか適応できないとこに留 意が必要である。シェラー定数Kは結晶粒の大きさ の定義や回折線幅の定義により値が異なるため (概 ね $0.32 \sim 1.33$)、ここでは簡便のためにK = 1とする。 そのため、今回の計算結果は実際の結晶粒の大きさ とは異なるが、あくまでシェラー定数Kの値のみ異 なるだけとなるので、試料間の比較には問題になら ない。回折線幅Bについてだが、一般的には FWHM(Full Width at Half Maximum: 全半値幅)が用 いられるが、測定装置固有の回折線の広がりを考慮 しなければならないため、十分に大きな結晶粒を持 つ標準試料の回折線の広がりを知る必要がある。し かし、我々は ITO の単結晶または十分に大きな結晶 粒を持つ多結晶は持っていないため、ITO に対する 装置固有の広がりを求めることができない。そこで、 GaAs 単結晶の値を参考にする。GaAs 単結晶の全 半値幅の測定を行った結果、0.02°以下であったの で、ここでは標準試料の広がりとして 0.02°を用い ることとする。さらに回折線幅Bは回折線の広がり の定義の仕方によっても求め方が変わる。今回は試 料と標準試料の回折線の形状をガウス関数によっ て定義する。ガウス関数は式(2)になり、ここでαは 最大値、bはピーク位置、cはガウス関数の広がり、 dはバックグラウンドバイアスである。また、ガウ ス関数において FWHM は式(3)で表される。これら を用いると回折線幅Bは式(4)で表される。

$$f(x) = a \exp\left\{\frac{(x-b)^2}{2c^2}\right\} + d$$
 式(2)
$$\text{FWHM} = 2c\sqrt{2\ln 2}$$
 式(3)
$$B = \left(B_{\text{試料}}^2 - B_{\text{標準試料}}^2\right)^{0.5}$$
 式(4)

図 6 に熱処理温度 400°C の ITO(400)の回折線に対して、ガウス関数をフィッティングさせた例を示す(縦軸は log. である)。フィッティングにはa=2100、b=35.25、c=0.45、d=400を用いた。この時 FWHM は 1.060°であった。この値より、回折線幅Bは 0.018 となり、結晶粒の大きさDは 87.5Åとなる。同様に 300°C、500°C で熱処理した試料について ITO(400)の回折線幅より、結晶粒の大きさを求めたものを表 2 に示す。この結果から、熱処理温

度 400°C の試料が最も結晶粒の大きさが小さく、500°C が最も大きくなった。熱処理の温度が上がることにより、結晶化が促されたと考えられるが、なぜ 300°C の方が 400°C よりも結晶粒が大きいのかについての理由は不明である。ただし、透明電極として用いることを考えると、伝導率や透過率といったパラメータの方が重要であり、これらのパラメータは結晶粒の大きさよりも、結晶粒間の接触の方が影響の度合いが大きいとの報告もあるため、400°Cで熱処理を行うことで透過率が下がっても電気伝導的に良い結果になることもあるので、現時点では400°C の熱処理が悪いことであるとは言えない。

5. おわりに

本年度の研究では ITO 透明電極について、新規に 導入したスパッタリングターゲットを用いて製膜 し、熱処理を行い、その結晶性について評価を行っ た。その結果、熱処理温度が 300°C では回折線の ピークが他の処理温度と比較すると弱く、また 500°C の試料では試料表面を肉眼で観察したとこ ろ、透明でない部分が出現していたことから、透明 電極として用いることが難しいことがわかった。さ らに、結晶粒の大きさについて評価を行ったが、処 理温度 400°C のものが 300°C よりも小さな値と なった。この理由については不明であるが、透明電 極としては結晶粒の大きさは必ずしも大きい方が 良いとは限らず、周りの結晶粒のとの接触が重要で あるとの報告もあることから、引き続き伝導率など の測定も行い、透明電極として最適な成長条件を見 つけたいと考えている。

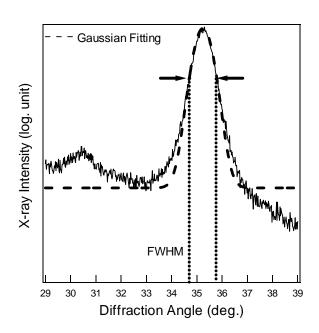


図 6 熱処理温度 400°C の ITO(400)の FWHM

表 2 結晶粒の大きさ

処理温度[°C]	FWHM[°]	<i>B</i> [rad]	θ [rad]	<i>D</i> [Å]
300	0.706	0.012	0.310	131.2
400	1.060	0.018	0.310	87.5
500	0.518	0.009	0.310	179.0

参考文献

- $\hbox{ (1)} \quad \hbox{P. Scherrer, G\"{o}ttinger Nachrichten Gesell., Vol. } \\$
 - 2, 1918, p 98.